――社会システムの変革を牽引するヘテロインテグレーション技術特集（和文論文誌 C）論文募集――

社会システムの変革を牽引するヘテロインテグレーション技術特集編集委員会

スマートデバイスの出現は私たちの一般生活に変化をもたらし，その普及にはエレクトロニクス業界における技術発展と産業的変化が欠かせませんでした．そしてエレクトロニクス技術の発展は，人工知能や自動運転を伴う自動車技術などの話題をより身近なものにしている一方で，その成立にはエレクトロニクス技術の更なる高度化を必要とするだけではなく，社会インフラなどの他産業との関わりを伴うものであろうことから一般化する前後には社会システムの変革が伴うことであろうと想像します．

翻って大量の情報を高速・高度に処理することを目的としたエレクトロニクス実装技術には，IC だけではなくセンサ，RF チップなどの異種チップとの混載技術，薄型軽量あるいは大面積化，かつ高速伝送化と低消費電力化が求められます．必要とされる高性能を実現するための回路設計，配線接続，デバイス化のためのプロセス技術やプロセス材料，信頼性評価に対する新しい思想と技術の獲得に日々の努力が存在します．

本特集では社会システムの変革を牽引するヘテロインテグレーション技術について，先進的で分野横断的な研究開発を進展させるために当該分野に関連する回路設計とその基盤技術，搭載デバイス技術，実装プロセス技術，実装材料，信頼性評価などの幅広い分野における論文を募集致します．

2019 年 3 月号の発行を予定しておりますので，多くの方々の積極的な御投稿を御願い致します．

1. 対象分野

- 三次元パッケージ／チップ／ウェーハ積層技術
- 三次元パッケージ／チップ／ウェーハ積層材料技術
- 貫通配線形成技術
- ウェーハ薄形化／加工技術（CMP，洗浄，エッチングなど）
- チップ／ウェーハ接着・接合技術
- パッケージ積層技術
- チップレベル／ウェーハレベルパッケージ技術
- シリコン及びガラス・インタポーザ技術
- 光／電気複合実装技術
- 耐熱性／放熱性材料及び製造技術（耐熱有機材料，高温はんだなど）
- フラックスレス及び無洗浄ソルダリング技術
- LED 実装技術
- パワーデバイス実装技術
- フレキシブル／プリンタブルエレクトロニクス
- ウェラブル端末用実装技術
- 環境発電／バッテリ技術（太陽電池，燃料電池など）
- ディスプレイ技術（有機 EL など）
- 有機インタポーザ技術
- サーマルマネジメント技術
- 実装・回路設計技術
- 評価及びシミュレーション技術
- 信頼性解析及び分析技術
- 新規材料及び製造技術（炭素系材料，生体系材料など）
- その他本特集テーマに関連する技術

2. 論文の執筆と取扱い

通常の和文論文誌と同様とし，論文は刷り上がりページ数 8 頁程度，ショートノートは 2 頁程度とします．執筆の詳細は，「和文論文誌 C 投稿のしおり」http://www.ieice.org/jpn/shiori/es_mokuji.html を御参照下さい．なお，査読後の再提出期間（通常は 60 日）を短縮する場合があることをあらかじめ御了承下さい．

3. 論文投稿締切　2018 年 6 月 11 日（月）

4. 論文投稿方法

https://review.ieice.org/regist/regist_baseinfo_j.aspx にアクセスし，投稿原稿の PDF ファイル・編集用電子ファイルを登録し，WEB 上で著作権譲渡手続きを進めて下さい．投稿手続きについて御不明な点がございましたら，学会事務局まで御連絡下さい．

【学会事務局連絡先】

一般社団法人電子情報通信学会編集出版部論文課
E-mail：wabun-c@ieice.org

【問合せ先】

安藤友之（東京応化工業株式会社）
TEL〔0467〕75-2151，E-mail：t-ando@tok.co.jp

5. 特集編集委員会

編集委員長　石榑崇明（慶大）
編 集 幹 事　安藤友之（東京応化工業）
編 集 委 員　青木豊広（日本 IBM），久我宣裕（横浜国大），石橋大二郎（富士通研），田久真也（リンテック），畑尾卓也（住友ベークライト），廣畑賢治（東芝），福島誉史（東北大），渡辺直也（産総研）